

2025年6月期 WEB 決算説明会（2025年8月13日開催）**およびアナリストミーティングの主な質疑応答****【新中長期経営計画「バリューアッププラン」】****1. なぜ「バリューアッププラン」を現時点で実施するのか？**

A: 当社は、従来の主力事業であったフラットパネル事業から、半導体・電子分野を中心とした事業ポートフォリオへの変革を進めています。この変革に伴い、東アジアに位置する大型工場の設備や生産体制の見直しが必要となり、企業文化も抜本的に変革する必要があります。

また、中国のローカル装置メーカーが急成長している状況において、競争に勝ち抜くためには技術優位性の維持が不可欠であり、そのための研究開発投資も継続しなければなりません。したがって、利益率をさらに向上させる必要があります。

これまでのビジネスの延長線上では利益率の向上は限定的であるため、抜本的な経営改革が必要であると判断しました。通常、経営改革は業績悪化時に行われますが、当社は利益があるうちに改革を進めることで、将来の成長を確実なものにしたいと考えています。

以上の理由から、現時点で「バリューアッププラン」を実施することを決定いたしました。

2. 事業改革のスケジュール感と事業売却・縮小等による利益率改善の見込みを教えてください。

A: 事業改革においては、低採算事業を徹底的に見直し、生産拠点の再構築や固定費の削減を 26/6 期～27/6 期の 2 年間で着実に実行します。これらの施策により、28/6 期の期初から収益率への寄与を見込み、同期には 25/6 期比で営業利益率ベース 5.5 ポイントの改善を目指します。

3. 半導体電子へのシフトやモジュール化による生産改革は、以前から取り組んでいると思うが、これまでと何が違うのか？

A: 従来から半導体電子分野の成長を見据え、事業のシフトを目指して社内のシステムや仕組み、ルールの見直しを進めてきました。今回、新たに全く異なる取り組みを行うのではなく、これまでの方針を踏まえつつ、数値目標の設定と対象機種具体化を進めたことで、具体的な目標を掲げ、本格的に稼働させる段階へと移行しております。これまでの取り組みに対してギアチェンジを行ったものご理解ください。

4. 成長戦略ではどのような方針でやっていくのか？ FPD 事業は続けるのか？

A: 成長戦略では、半導体・電子分野を中心にさらなる成長を目指し、既存事業間のシナジーを最大限に活用して新たな半導体・電子関連ビジネスを創出していきます。具体的には、半導体・電子事業への注力を一層強化し、成長を加速させるとともに、特に今後の成長が期待される AI 関連ビジネスを中心に多くの成長機会を捉え、当社の技術力と事業基盤を活かして事業を拡大していきます。

また、M&A を活用したビジネス拡大も視野に入れて取り組んでいきます。

FPD 事業については取り組みを継続し、日本国内から海外へビジネスが移っている状況を踏まえ、海外生産を積極的に展開することで、利益率の高いビジネスへと転換していきます。

半導体・電子分野を中心とした事業ポートフォリオへの変革を通じて、事業基盤を強化し、高成長・高収益性の実現を目指していきます。

5. 31/6期の営業利益790億円、営業利益率22%はどのように実現するのか？

- A:** 最初のステップである「事業改革」では、低採算事業を徹底的に見直し、生産拠点の再構築や固定費の削減を2年間で完遂することで、28/6期までに25/6期比で営業利益率を5.5ポイント改善することを目指します。次に「生産改革」では、モジュラーデザインの徹底推進により生産効率を大きく向上させ、収益基盤を強化していきます。対象となる装置事業においては、25/6期比で営業利益率を12ポイント改善する計画です。これらの改革を基盤に成長戦略を推進し、31/6期までに売上高を約1,100億円増加させ、トップラインの拡大を図っていきます。
- こうした取り組みにより、連結全体で31/6期に営業利益790億円、営業利益率22%の達成を目指します。

6. 半導体ロジック・メモリの成長戦略は？

- A:** 市場が長期的に成長していくことによる既存工程の拡大に加え、先端半導体の新しい用途・工程でのPORを獲得し、事業拡大を目指します。さらに、工程獲得の増加に伴い装置設置数も増加していくため、CS（カスタマーサービス）ビジネスの拡大にも注力していきます。これらの戦略に基づき、研究開発を強化するとともに重要顧客との共同開発を一層加速させていきます。

ロジック

拡販が進んでいる5ナノ、3ナノのデファクトスタンダードであるTiN MHMの横展開に加え、ストレス制御・低パーティクル成膜を強みとしたHM（ハードマスク）技術の展開により、HM工程でのトップシェアを確立していきます。また、将来的には市場規模の大きい配線工程でのビジネス獲得、新材料・低抵抗成膜技術の開発等による事業拡大を視野に入れ、さらにシェアを伸ばしていく方針です。

メモリ

韓国のトップメーカーと連携し、テクノロジーセンターを活用した共同開発を加速させ工程数拡大を図っています。また、新材料や新構造に対応したソリューションの提供を推進し、新たなPORを獲得していくことで、メモリ工程におけるシェアの最大化を目指します。

7. パワーデバイス・パッケージングの成長戦略は？

A: パワーデバイス

中国市場では足もとで投資回復の兆しも見え、SiC8インチ化への投資が進む見込みだが、日本市場ではEV市場の成長鈍化により投資再開まで1年超を要することが予想され、パワーデバイス市場の本格回復は27/6期以降を見込んでいます。このような事業環境の下、中国市場におけるイオン注入装置シェアNo.1のポジションを活かし、市場回復に伴う成長を確実にするとともに、次世代パワーデバイスである窒化ガリウム（GaN）対応の技術展開等の新素材での市場開拓を強化していくことで、さらなるシェア拡大を目指します。

パッケージング

先端インターポーザー用デスクラム工程向けアッシング装置シェアNo.1の実績をベースに、顧客技術ロードマップに合わせ、プラズマ技術を強みとした先端パッケージング向け装置を順次リリースしていくことで、パッケージ基板拡大機会や次世代パッケージング市場を獲得し、唯一無二の存在としてポジションを構築していきます。

【25/6期実績】

8. 3Q修正予想に対して、受注高・売上高・営業利益の増減要因は？

A: 売上高や各利益項目は概ね前回 3Q 修正の予想通りの着地し、特に売上総利益率は 31.8%と、上場以来の最高水準を達成しました。

受注高・売上高

受注高は、大手パワーデバイスメーカーを中心に引合い案件が増加し、4Q から受注増加を期待していたが、来期へ期ずれしたことなど、パワーデバイスの弱含みによって若干の未達となりました。売上高においては、高水準の受注残高の寄与等により、上場来 2 番目に高い水準での着地しました。

営業利益（率）

売上高の減少に加え、今後の成長に向けた研究開発費を前期より増やしたことにより、前期比で少し低下しましたが、仮に研究開発費を除いた場合の営業利益率は、着実に改善しています。

【26/6期連結業績予想】

9. 26/6期計画は下期偏重になっているがなぜか？

A: 上期から下期にかけて受注の回復を見込んでおり、製造リードタイムの短縮による受注残高の売上計上が確実に進む計画です。また、利益面においては、収益性の高い半導体事業の計画が下期偏重となっていることが大きな要因となっています。

10. 26/6期における事業改革による業績影響は？

A: 各施策の進捗にもよりますが、売上高ベースで 80 億円～100 億円程度の剥落を見込んでおります。半導体電子事業を中心とした成長による増収でカバーできると見ており、業績への影響は限定的な範囲に留まる想定です。

11. 関税の影響は？

A: 基本的に関税については、買い手負担を適用しているため、関税による直接影響は限定的です。エンド需要減速による間接影響を引き続き注視していきます。また、現時点で顧客からの受注に目立った変化ありません。なお、半導体関連の政策が不透明な状況であることから、通期業績予想には関税影響は織り込んでおりません。

以上